

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2023-015

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第二届董事第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》的相关规定，公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

为满足公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、贸易融资、研发及固定资产贷款等，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。该综合授信事项有效期为两年，在授信期限内，授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高效率，公司董事会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2023年3月22日